### (19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 7. April 2005 (07.04.2005)

#### PCT

# (10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2005/031808 A2

- (51) Internationale Patentklassifikation7: H01L 21/00
- PCT/EP2004/052096 (21) Internationales Aktenzeichen:
- (22) Internationales Anmeldedatum:

9. September 2004 (09.09.2004)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

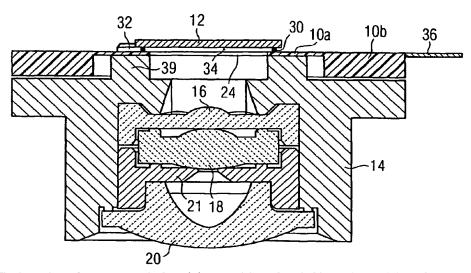
Deutsch

- (30) Angaben zur Priorität: 26. September 2003 (26.09.2003) 10344767.9
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): FRENZEL, Henryk [DE/DE]; Lieblstrasse 8, 93059 Regensburg (DE).

- SIEMENS AKTIENGE-(74) Gemeinsamer Vertreter: SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: OPTICAL MODULE AND OPTICAL SYSTEM
- (54) Bezeichnung: OPTISCHES MODUL UND OPTISCHES SYSTEM



(57) Abstract: The invention relates to an optical module comprising a lens holder (14) containing a lens arrangement consisting of, for example, three lenses (16, 18, 20) and a diaphragm (21). Preferably, the lenses (16, 18, 20) and optionally the diaphragm (21) are unequivocally oriented by the geometrical form unereof in such a way unating only or any and a thick region (10b) the invention, the optical module has a specially embodied circuit carrier (10) comprising a thin region (10a) and a thick region (10b) are in a few the thin region (10a) preferably carrying a semiconductor element (12). Along with the particularly low tolerances between the semiconductor element (12) and the lens unit (14; 16, 18, 20; 21), the invention advantageously enables a more reliable assembly (e.g. soldering, gluing or the like) of a semiconductor element (12), for example by means of a flip-chip technique, on a thin and thus relatively stable, flat plane (10a), than comparable assembly processes of components on exclusively flexible circuit carriers. The invention is especially suitable for applying inside a motor vehicle or on the outside of the same.

## WO 2005/031808 A2



TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

#### Veröffentlicht:

 ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts

(57) Zusammenfassung: Ein optisches Modul weist einen Linsenhalter (14) auf, in den eine Linsenanordnung aus beispielsweise drei Linsen (16, 18, 20) und einer Blende (21) eingesetzt ist. Vorzugsweise sind die Linsen (16, 18, 20) nebst ggf. Blende (21) durch ihre geometrische Gestaltung eindeutig ausgerichtet, so dass einerseits keine weitere optische Justierung erforderlich ist. Erfindungsgemäß weist das optische Modul einen speziell ausgebildeten Schaltungsträger (10) auf, umfassend einen dünnen Bereich (10a) und einen den dünnen, relativ empfindlichen, Bereich (10a) wie in einem Rahmen halternden dicken Bereich (10b), wobei vorzugsweise der dünnen Bereich (10a) ein Halbleiterelement (12) trägt. Neben den besonders geringen Toleranzen zwischen dem Halbleiterelement (12) und der Linseneinheit (14; 16, 18, 20; 21) erlaubt die vorliegende Erfindung vorteilhaft eine zuverlässigere Montage (z.B. löten, kleben oder dergleichen) eines Halbleiterelements (12), beispielsweise mittels Flip-Chip-Technik, auf einer dünnen und dennoch relativ stabilen, planen Ebene (10a), als bei vergleichbaren Montageprozessen von Bauelementen auf ausschließlich flexibel ausgebildeten Schaltungsträgern. Die Erfindung eignet sich insbesondere bei Anwendungen im Innen- oder Außenbereich eines Kraftfahrzeugs.